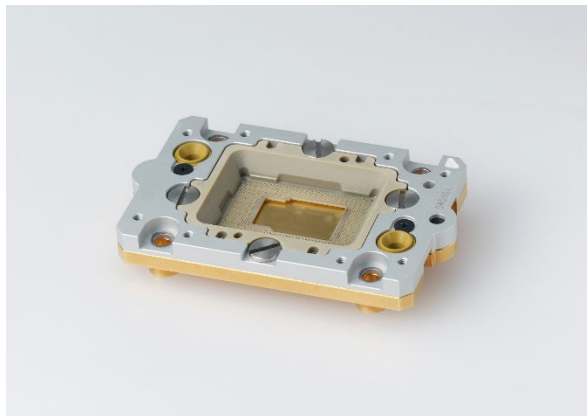


**NEWS RELEASE**

**ヨコオとして初めて、  
「5G 通信対応 0.4mm ピッチ、フルシールド高周波ソケット」を新開発**  
～ プローブを 0.4mm ピッチで配置し、かつ 28GHz 帯で使用可能な半導体検査ソケット ～



5G 通信対応 0.4mm ピッチ、フルシールド高周波ソケット

株式会社ヨコオ(本社:東京都北区、社長:徳間孝之)は、このたび、半導体の後工程検査で使用する検査用ソケットとして、**ヨコオとして初めて「5G 通信(28GHz 帯)対応 0.4mm ピッチ、フルシールド高周波ソケット」を開発**し、現在、量産化に向け最終評価を実施しています。

新開発の「5G 対応 0.4mm ピッチ、フルシールド高周波ソケット」は、これまで、プローブを配置させる最小ピッチ(間隔)が 0.65mm だったところ、50%のサイズに小型化した新開発のインシュレーターリングを使用することで、0.4mm ピッチでの配置を実現しています。さらに、ソケット上側のプランジャー部分もメタルブロックで覆うことが可能になり、樹脂プレートを使う従来の方法に比べ同軸構造を多く確保でき、高周波対応としては非常に有効な構造にすることが可能になります。

また、ピンプレート部分も、樹脂から金属に変えフルシールド化するなど、同軸構造部分を拡張し、高周波性能を向上させることで、5G通信(28GHz)への対応を実現しています。

今回、新開発のインシュレーターリングを開発・製造するために、新型の樹脂成形機を導入したことに加え、極小インシュレーターリングを安定した品質で製造し続けるために、長年に渡るヨコオ独自の微細加工技術を駆使し、幾重にも渡るテストを繰り返した結果、製品化することに成功しました。

後工程検査ソケットは樹脂製のハウジングで製造するのが一般的ですが、5G 通信の本格運用に伴い、高周波特性で有利な金属製ハウジングによる同軸性能を採用したハイギガソケットが求められています。今回、極小インシュレーターリングの開発だけではなく、ピンプレート部の金属化や、金属ボディでも精度が高く、アッセンブリーしやすい構造を採用するなど、独自のノウハウを駆使し、ヨコオ初となる「5G 対応 0.4mm ピッチ、フルシールド高周波ソケット」を開発しました。

これからも、28GHz 帯の 5G 通信需要は伸びてくると予想されますが、長年培ってきたコア技術を生かし、今後も貢献してまいります。

## <参考資料>

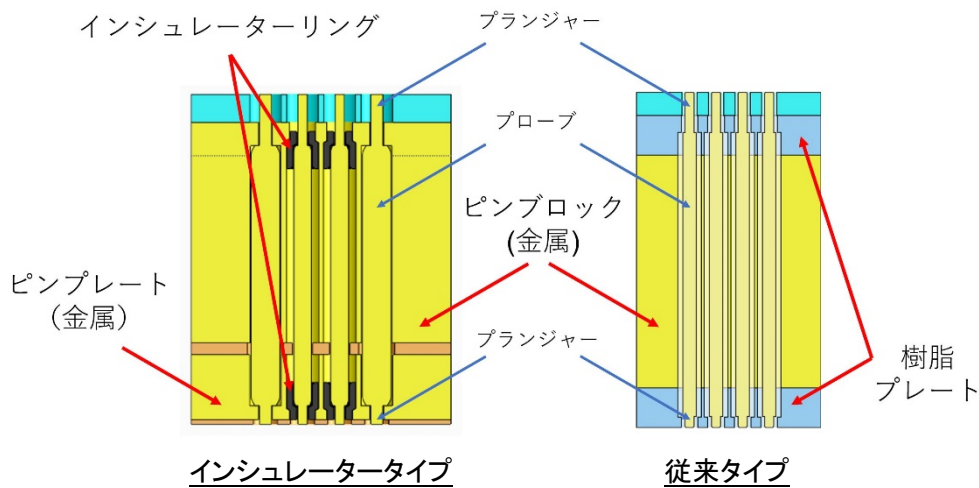
### ■ 製品名

5G 通信対応 0.4mm ピッチ、フルシールド高周波ソケット

### ■ 用途

5G 通信(28GHz 帯)対応、半導体の後工程検査用ソケット

### ■ 製品特徴



- ・ 極小インシュレーターリングを使用し、0.4mm ピッチでプローブを配置することが可能
- ・ プローブ上部のブランジャー部分も金属で被うことが可能になり、同軸部分を確保
- ・ 樹脂プレートを金属に置き換えることで同軸構造を多く確保し、高周波機能を向上

(注) ニュースリリースに記載されている内容は報道発表日時点の情報です。その後、予告なしに変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。

#### ◇ 販売に関するお問い合わせ先

株式会社ヨコオ CTC 事業部 営業部/藤木

TEL: 03-3916-3116

携帯: 090-5198-7276

#### ◇ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ヨコオ 広報・株式部 松本 / 禪院(ぜんいん)

TEL: 03-3916-3179

携帯: 080-2275-3255(松本)

E-mail: [h-matsumoto@jp.yokowo.com](mailto:h-matsumoto@jp.yokowo.com)